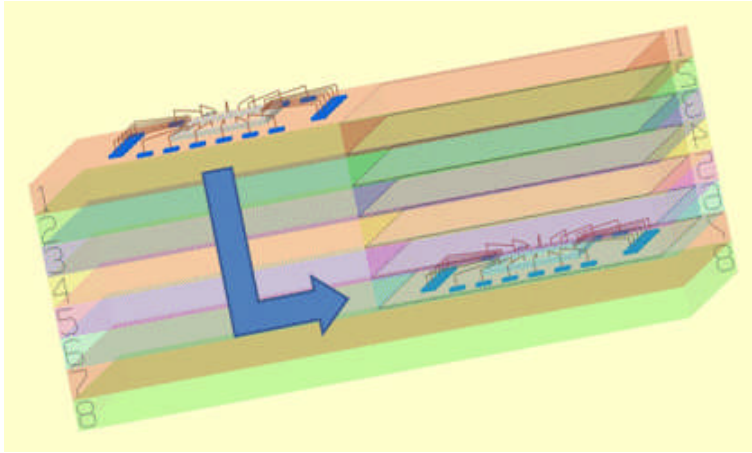


Neuheiten Version 13

Inhalt

1. Mit der neuen **DYNPART Eigenschaft** können jetzt alle SMD Bauteile DIE's mit Bonddrähten und Bondpads auf jedes beliebige Tape sozusagen vertikal verschoben oder kopiert werden. Somit entfällt jede Neuerstellung eines Bauteils für ein anderes Tape oder die Unterseite. Details sind unter dem Kapitel [Dynamisch erstellte Bauteile LTCC](#) zu finden.



2. Toolbox **Tape-Bauteil erstellen** als Hilfe zur Erstellung von tape-innenliegenden Bauteilen (LTCC), zu finden im Pulldownmenü **Spezial, Bauteil erstellen/bearbeiten**, siehe [LTCC, Menü Spezial, Tape-Bauteil erstellen](#).

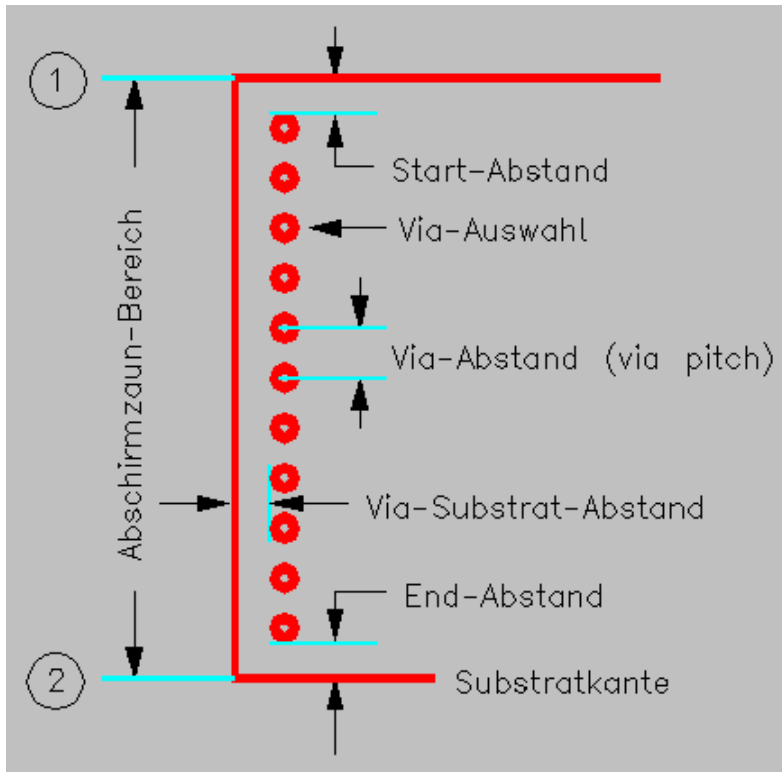
Tape-Bauteil erstellen				
Tapenummer:		T	1	- +
Bauteil-Umriss:		1176		Setzen
Bauteil-Keepout:		1177		Setzen
Bauteil-Pad:		1178		Setzen
DIE-Pad:		1179		Setzen
Referenzbez.:	L	1180		Zufügen
Typ:	Type	1181		Zufügen
Bauteilnummer:	part-no	1185		Zufügen
Bestückungs Info:	zeichnung	1184		Zufügen
Bauteilinfo:	T-Attrib	1184		Zufügen
Physikal. Anschl.:	@DIE-Pad	1182		Zufügen
Logischer Anschl.:	@DIE-Pad	1183		Zufügen
Elektr. Prüfung:	ENN	0.200	✓	Zufügen
Platzierungspr.:	PPP	0.200	✓	Zufügen
Logische Ebene:	1			
Zurücksetzen	Einstellung sichern			
Schließen				

Durch die Festlegung der Tapenummer

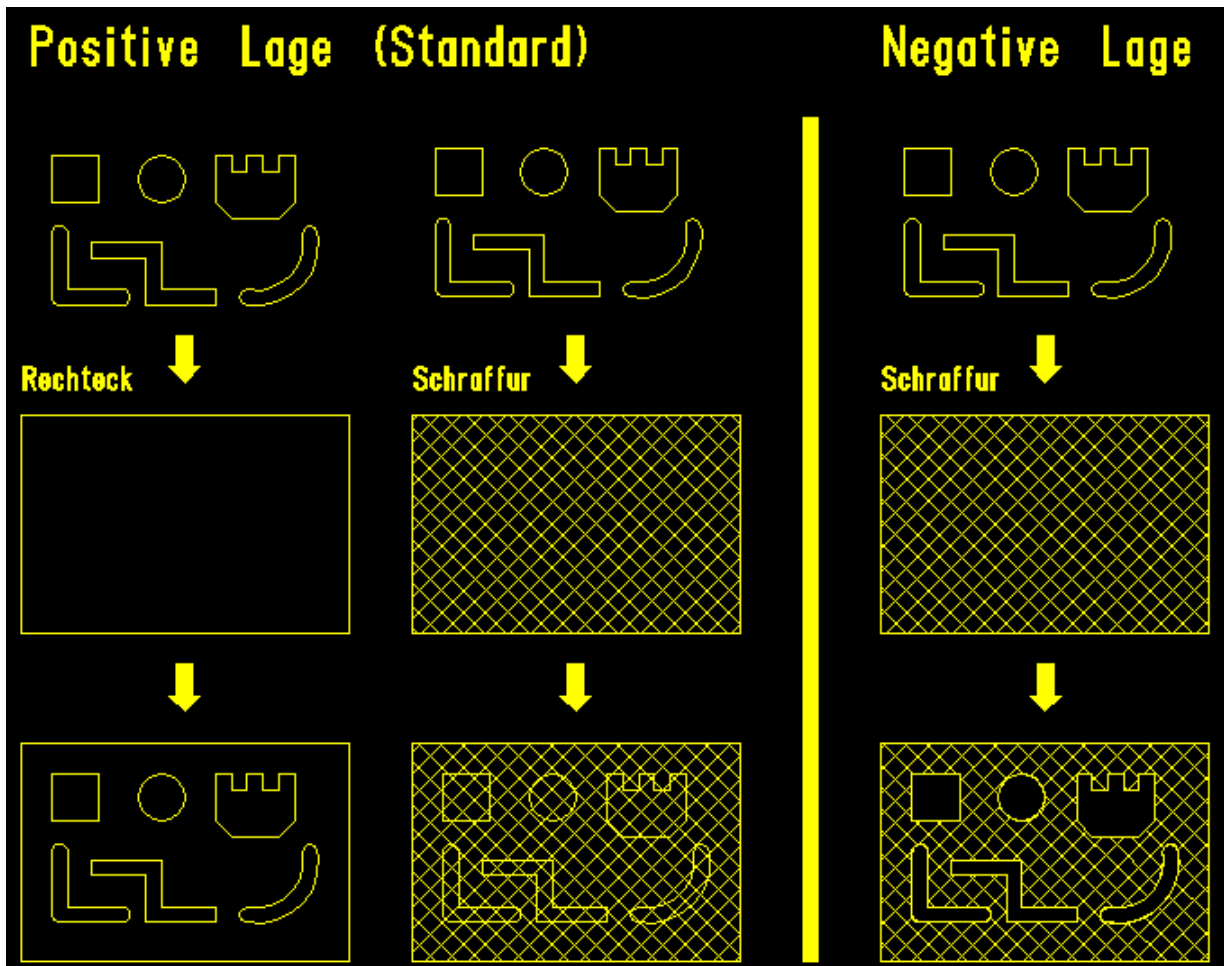


werden automatisch alle Lagen zu dem betreffenden Tape-Bauteil zugeordnet

3. **Automatische Anschlussvergabe** für BGA-Bauteile und große Stecker ist neu, siehe [HLM, Menü Spezial, Automatische Anschlussvergabe](#).



5. Negative Lagen (Prozessdatei) sind neu. Das ist eine typische grafische Eigenschaft. In den Layout-Modulen kann eine negative Lage als Isolations- und/oder Verbindungslage benutzt werden. Derzeit unterstützt der 2-Punkt-Router keine negativen Lagen. Wenn negative Lagen in andere Datenformate exportiert werden (DXF/DWG, GDSII, ARCHIVE), kann die Ausgabe einer negativen Lage entweder mit allen Komponenten erfolgen oder als resultierende Schraffuren. Bei den Formaten UDOUT und MIFOUT wird immer eine resultierende Schraffur ausgegeben. Weitere Details finden Sie im Kapitel [Negative Lage](#).



6. DRC-Cavity-Prüfungen in einer eigenen Toolbox verfügbar, siehe [DRC Cavitytest LTCC](#). Geprüft wird dabei die Fläche und die äußeren Abmessungen der Cavities sowie die Anzahl der Tapes, die sich unter- und oberhalb des Cavity-Bodens befinden.

DRC-Cavity-Test			
Tapes:	*		
Abmessungen:	3	4	—
Fläche:	12	18	—
Tapes darüber:	2	4	—
Tapes darunter:	2	4	—
Schließen			
Einst. sichern			

7. Eine komplett neu überarbeitete und erweiterte **Filmvorlagen**-Funktion für eine viel leichtere Handhabung, siehe **Postprozessoren**, [Filmvorlage erstellen](#).

Filmvorlage erstellen			
Zeichnung:	example		
Fotoplot-Zeichnung:	example_phol	-	+
Filmkontroll-Datei:	example_fcfl.cfg	-	+
Filmfeld-Zeichnung:	40x40_c	Param	
Filmgröße auswählen:	700x350 (4x2)	3	
Kunden-Makro ausführ.:	—		
Standard-Einstellungen			
Filmfelder definieren			
Zurücksetzen		Einst. sichern	
Schließen		WEITER	


8. **Bauteil erstellen/beschriften** vom Pulldownmenü **Datei** nach Pulldownmenü **Spezial** verschoben. Es wurde nicht nur verändert sondern auch um alle notwendigen Lagen erweitert, siehe **PCB**, Menü **Spezial**, [Bauteil beschriften PCB](#), **HLM**, Menü **Spezial**, [Bauteil beschriften HLM](#), **LTCC**, Menü **Spezial**, [Bauteil beschriften LTCC](#).
9. **Bonddraht-Längentest** in das Pulldownmenü **DRC/Prüfungen** verschoben, siehe **HLM**, **DRC HLM**, [DRC Bonddraht-Längentest HLM](#).
10. Im Pulldownmenü **Spezial**, **Postprozessoren** finden Sie jetzt:
1. die Materiallisten-Erstellung/Bearbeitung
 2. eine komfortable Layout-Skalierung (in X/Y unterschiedlich) (LTCC)
 3. eine vollkommen neu überarbeitete und erweiterte Filmvorlagen-Erstellung
 4. den Gerber-Postprozessor
 5. den Bohr- und Fräs-Postprozessor
 6. 4 Möglichkeiten für die SMD-Bestückungsausgabe. Die flexibelste Ausgabe ist dabei das Panasonic-Format, welches über Meldungsdateieinträge in der **gedit.ms** individuell konfiguriert werden kann.
 7. den 3D-Tapeviewer (Hybrid/LTCC)
 8. eine Testpunktkoordinaten-Ausgabe
 9. die Thermische Simulation (nur für Hybride)
11. Erweiterung für DXF/DWG Export: Es werden nur die benutzten Lagendefinitionen (nicht mehr alle) in die Ausgabedatei geschrieben. Dadurch werden viel kleinere dxf/dwg-Dateien erzeugt. Meldungsdatei-Eintrag: edxfout_used_layers_only ON (default)

12. Die GRAFFY/HYDE-Software kann unter dem neuen Microsoft-Betriebssystem: **Windows 7** problemlos installiert und betrieben werden.

Ferner wurden zur leichteren Bearbeitung neue Icons eingeführt und alle Makros und Toolboxen überarbeitet. Falls notwendig überprüfen Sie alle Makros in Ihren Customize-Dateien, soweit diese auf bereits existierende Standard-Makros zugreifen.

Die Konfigurationsdateien der meisten Toolboxen werden jetzt im aktuellen Projektverzeichnis abgespeichert. Dateiname und Pfad werden im entsprechenden Tooltip angezeigt. Überprüfen Sie unbedingt, dass Ihre abgespeicherten Konfigurationsdateien mit der aktuellen Konfiguration übereinstimmt, z.B. Print-Toolbox, u. a.

Weitere Änderungen und Verbesserungen (allgemein)

- Die Funktionstaste F12 schaltet jetzt im Grafikeditor nacheinander zwischen schwarzem, weißem und grauem Hintergrund um. Die Funktionstaste F11 wurde deaktiviert.
- Der Verschmelze-Befehl hat eine neue Option erhalten:  konvertiert jede Flächenkomponente in eine Schraffur.

Weitere Änderungen und Verbesserungen (für Makro-Programmierer)

- Neue Option für den **ADD RECHTECK** Befehl:
Option :X (Länge) mit :Y (Höhe) wahlweise mit :C (X,Y) dem Cursorplatzierungspunkt
- Neue Option für den **LÖSCHE**-Befehl:
Option: :T (Textattribut)
Löschen aller Texte mit dem vorgegebenem Attribut in der aktuellen Zeichnung.
- Der Drillmill-Postprozessor wurde beim Programmaufruf um eine Option erweitert, dass individuelle Lagenummer(n) übergeben werden können (Option -l).